

보도시점 2026.10.28.(수) 06:00
< 10. 28.(수) 석간 >

배포 2026. 10. 27.(화)

소부장과 뿌리기술, 산업을 연결하는 힘

- 2026년 소재부품장비-뿌리기술 대전 개최 -
- 산업부, 뿌리산업의 차세대 경영인들과 공정혁신의 해법 모색 -
- '26년 소재·부품·장비 으뜸기업 21개사 지정서 수여 -

산업통상부(장관 김정관, 이하 산업부)는 10월 28일(수)부터 30일(금)까지 일산 킨텍스 제1전시장에서 「2026 소재·부품·장비-뿌리기술대전」이 개최된다고 밝혔다.

「소재·부품·장비-뿌리기술대전」은 산업의 성과 공유와 기업 간 교류·협력 촉진을 위해 소재부품기술상 시상식과 유관 행사를 통합하여 2011년부터 매년 개최해 온 소부장·뿌리산업 종합박람회다.

이번 행사는 'Deep Connect-소부장과 뿌리기술, 산업을 연결하는 힘'을 슬로건으로 소재·부품·장비(이하 소부장) 및 뿌리산업의 첨단기술 성과와 미래비전을 공유하는 종합전시 행사, 비즈니스 상담, 포럼·세미나 등의 프로그램이 운영된다.

종합전시 행사에서는 반도체·디스플레이·이차전지 등 다양한 분야의 혁신기업 전시관을 비롯해 으뜸기업 홍보관, 수요-공급기업 네트워킹관, 뿌리산업정보관, 탄소중립관 등 6개 전시관이 운영된다. 비즈니스 상담에서는 기술상담과 수요기업 구매상담, 수출컨설팅, 정책금융·민간투자 상담 등을 통해 기업의 기술개발부터 판로개척과 투자유치까지 전 주기에 걸친 지원 프로그램을 제공한다.

10월 28일 개최되는 개막식에서는 산업공급망 발전에 기여한 유공자에 대한 포상이 수여된다. 고정밀·고효율 TC본더 기술개발을 통해 세계시장 점유율 1위 달성에 기여한 한미반도체(주) 김병석 상무이사(은택산업훈장), 유리 기반 초미세·박막 필름 터치센서 기술 확보로 시장 확대와 신사업

창출에 기여한 동우화인켐(주) 배우현 전무(철탑산업훈장) 등 정부포상 20점을 포함해 총 72명이 수상의 영예를 안았다. 정부포상 수상자들에게는 장은 공익재단이 제공하는 포상금도 수여된다.

이와 함께 뿌리산업에서 대를 이어 기술을 계승·발전시켜 온 삼영엠티(주), 에이치에프엠 등 뿌리기업 명가 4개사와 근무·복지환경 등이 우수한 ‘일하기 좋은 뿌리기업’ 5개사에 선정증을 수여한다. 뿌리기업 명가는 20년 이상 경영을 이어오고 가업승계를 완료한 기업 중 매년 선정하며, 올해까지 총 81개사가 선정됐다.

같은 날 오후에는 ‘뿌리산업 차세대 리더스 포럼’을 개최한다. 기존 1세대 창업주가 쌓아온 기술을 활용해 신시장에 진출하거나, 데이터와 AI 기반으로 공정을 개선하고자 하는 차세대 경영인 10여명이 참석하여, 승계 이후 현장에서 부딪히는 애로와 공정혁신 방안을 논의한다. 또한, 행사 기간에는 투자·금융 세미나, 수요-공급기업 네트워킹데이, 투자지원금사업 워크숍 등도 진행된다.

10월 29일에는 '26년 선정된 소부장 으뜸기업(6기) 21개사에 지정서를 수여할 예정이다. 으뜸기업은 소부장 핵심전략기술을 보유하고 글로벌 성장 가능성이 높은 기업으로, '26년 새롭게 선정된 으뜸기업을 포함할 경우 총 120개 사가 지정되었다.

산업통상부 양기욱 자원안보정책실장은 축사에서 “정부는 소부장과 뿌리산업의 경쟁력을 높여 대체불가 산업강국으로 도약할 수 있도록 기술개발과 기업 육성, 협력 생태계 강화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이어, “뿌리산업 현장의 혁신을 자발적으로 이끌고 있는 2세 경영인들을 지속 발굴하고, 승계 이후 어려운 대외 여건 속에서도 지속적으로 성장할 수 있도록 현장의 애로를 세심히 살펴나가겠다”고 강조했다.

담당 부서	산업공급망정책관 산업공급망정책과	책임자	과 장	권덕중 (044-203-4910)
		담당자	사무관	지 영 (044-203-4917)
			주무관	김진이 (044-203-4903)
	뿌리산업팀	책임자	팀 장	정초원 (044-203-4905)
		담당자	주무관	김정아 (044-203-4907)

□ 목 적

- 산업공급망(소재·부품·장비 및 뿌리산업)을 망라하는 종합박람회로 정보 교류, 기술 홍보, 투자상담 등 협력의 장 마련

□ 슬로건: “Deep Connect”, 소부장과 뿌리기술, 산업을 연결하는 힘

□ 일 정: 2026.10.28.(수) ~ 10.30.(금)

* (주최) 한국산업기술진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국생산기술연구원, 한국소재부품장비투자기관협의회, 대한무역투자진흥공사, 한국국제전시장, (후원)장은공익재단

□ 주요 프로그램

- 소부장·뿌리 기업의 기술개발, 판로개척 등 성장발판 마련을 위한 투자·정책금융 지원과 상담 등 위한 소주기 프로그램 제공

분야	주요 프로그램	
전시장	① 혁신기업 전시관 ♦ 반도체, 디스플레이, 이차전지 제품 등 홍보	④ 유공자관 ♦ 정부포상 유공자 특별 전시 공간 조성
	② 수요-공급기업 네트워킹관 ♦ 양산성능평가지원사업 및 우수제품 홍보	⑤ 으뜸기업 홍보관 ♦ 으뜸기업 제도 소개, 성과 등 전시
	③ 뿌리산업정보관 ♦ 뿌리산업 우수모델 전시, 지원사업 소개	⑥ 탄소중립관 ♦ 소부장 기업 대상 탄소중립 사업 홍보
비즈니스 상담관	① 융합혁신지원관 ♦ 소부장 기업지원 사업의 중단계 소개 및 기술상담	③ 수요기업 구매상담회 ♦ 소부장-대기업 바이어 간 1:1 비즈매칭
	② 혁신·금융 커넥트관 ♦ 정책금융 및 민간투자 유치 지원·상담	④ 수출컨설팅·상담관 ♦ 바이어 매칭 및 상담 통한 GVC 진입 지원
포럼 / 세미나	① 투자·금융 세미나 ♦ 기업 투자·금융지원 사업 안내	④ 차세대 리더스 포럼 ♦ 뿌리산업 차세대 경영인 네트워크 구축
	② 뿌리산업 세미나 ♦ 뿌리산업 기술·산업 동향 및 발전 방안 공유	⑤ 투자지원금사업 워크숍 ♦ 투자지원금사업 규정 설명회 및 교류회
	③ 수요-공급기업 네트워킹데이 ♦ 양산성능평가지원사업 우수제품 설명회	⑥ 연구개발 관리규정 설명회 ♦ 공통운영요령 및 연구개발비 집행 관련 설명회

참고2

소부장 · 뿌리산업 발전 유공자 주요 명단

구분	소속	이름	직위	공적 사항	
소재 부품 장비 산업 (16)	산업훈장 (은탑)	한미반도체 주식회사	김병석	상무 이사	고정밀, 고효율 TC본더 기술 개발을 통한 세계시장 점유율 1위에 기여
	산업훈장 (철탑)	동우 화인캠	배우현	전무	Glass 기반 초미세·박막 Film 터치센서 기술 확보를 통한 시장 확장 및 신사업 창출에 기여
	산업훈장 (석탑)	엘지 이노텍	박제경	팀장	자율주행 및 차량용 카메라 핵심 기술을 선제 개발하고, 글로벌 완성차 OEM 양산 수주에 기여
	산업포장	엘지 디스플레이	곽태형	상무	고효율/고성능 Display용 재료 개발을 통한 소부장 산업발전 및 ESG 기여
		미코 세라믹스	진정철	이사	650℃급 초고온용 질화알루미늄 세라믹 히터 개발을 통한 부품 국산화 달성에 기여
	대통령 표창	픽셀	최효훈	대표 이사	AI 기반 PCB 외관 검사장비 상용화를 통한 공정혁신 및 수입장비 국산화에 기여
		삼성전자	김운호	팀장	차세대 반도체 EUV 소재 개발 및 재생 신기술 국산화를 통한 초격자 소재 경쟁력 확보에 기여
		나노종합 기술원	-	단체	300mm/200mm 반도체 소부장 테스트베드 기반 실증·양산평가 지원으로 상용화 촉진 및 산업기술 경쟁력 강화에 기여
		원익 큐엔씨	-	단체	첨단 반도체용 핵심 부품 국산화, 생산·R&D 역량 강화를 통해 소재 공급망 안정 및 전략 국가산업 경쟁력 제고에 기여
		세메스	-	단체	반도체·디스플레이 전(全) 공정 설비 국산화 및 첨단 물류 자동화 솔루션 구축을 통한 국내 소부장 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여
		아이비케이 캐피탈	-	단체	소부장 유망기업에 대한 전략적 투자와 정책연계형 자금지원을 통해 사업화 촉진 및 산업 경쟁력 강화에 기여
	국무 총리 표창	에이치제이 웨이브	유태환	대표 이사	밀리미터웨이브 RF 기반 검사장비 및 안테나 개발로 생산기간 단축·경량화·비용절감을 통해 국산화 및 공급망 안정화에 기여
		에이케이 실트론	김자영	부사장	고성능 반도체 수요에 대응한 차세대 웨이퍼 품질 혁신 및 자체 정밀 계측 기술 개발에 기여
		리셋 컴퍼니	-	단체	태양광 폐패널 고순도 소재 추출용 장비 국산화를 통한 재자원화 산업 생태계 활성화에 기여
		코미코	-	단체	반도체 장비 부품용 특수 코팅기술 개발을 통해 반도체 공정 안정화, 부품 수명 연장 및 수입대체에 기여
		저스텝	-	단체	반도체 웨이퍼 불량률 제고를 위한 N2 Purge 기술 국산화 개발 및 관련 제품 사업화에 기여
뿌리 산업 (4)	대통령 표창	제이미크론	황재익	대표 이사	반도체·디스플레이용 핵심 장비 부품의 고정밀 표면처리 기술 국산화에 기여
		삼영엠티	-	단체	중대형 알루미늄 다이캐스팅 생산기반 구축과 글로벌 수출 확대에 기여
	국무 총리 표창	디팜스테크	최복석	전무	금형 최적화와 AI 자동생산 시스템 구축을 통해 초정밀 사출제품의 품질과 양산 안정성 확보에 기여
		에이치 에프엠	-	단체	국내 최초 단조 프레스 연동기계를 개발·상용화하여 인력 의존형 공정의 자동화 전환에 기여

참고3

2026년 선정된 우수 뿌리기업 목록

□ 뿌리기업 명가 선정기업 (4개社)

기업명	대표자	업종	주요 생산품
삼영엠티(주)	정원영 정재석	주조	자동차용 알루미늄 다이캐스팅 부품
주식회사 에이치에프엠	정종호	금형	열간단조프레스, 금형 및 주변기기
(주)세왕섬유	최재락 최원석	표면처리	직물, 편조원단 및 의복류 염색 가공업
(주)원진알루미늄	원태연	소성가공	알루미늄 압출형재, 금속 합성수지제창, 난간 등

* 대를 잇는 전통 확산을 위해 20년 이상 경영, 가업 승계기업

□ 일하기 좋은 뿌리기업 선정기업 (5개社)

기업명	대표자	업종	주요 생산품
(유)한성산기	백대준	금형	수중펌프, 수중모터펌프, 액체펌프
부곡스텐레스(주)	홍성박 홍완표	소성가공	스테인리스 파이프 튜브 이형단면재 외 특수강
(주)유에스티	방민규	용접	반도체 핵심 소재부품
(주)세왕섬유 시화공장	최재락 최원석	표면처리	직물, 편조원단 및 의복류 염색 가공업
알루스(주)	정낙철 정종욱	주조	알루미늄 빌렛

* 근무·복지환경, 경영 안정성, 성장역량 등이 우수한 뿌리기업

참고4

2026년 소부장 으뜸기업 지정서 수여기업

연번	분야	기관명	핵심전략기술
1	기계 금속	에스에이치팩	유체의 힘을 이용하여 작업 장치에 움직임을 발생시키는 부품 제조 기술
2		제일연마공업	다양한 재료를 연마 하는데 사용하는 소재부품 제조 기술
3		데크카본	극한 환경에서 적용 가능한 극한 환경용 복합재료제조 기술
4		화천기공	다축 절삭 가공장비 제조 기술: 부품을 정밀하게 고속으로 자동 가공하는 절삭 가공장비 제조, 설계 기술
5		엑스비스	광학을 이용한 가공장비와 광학가공장비를 구성하는 소스, 모듈, 제어 시스템 제조 기술
6		링크솔루션	
7	기초 화학	ICEI 우방	고성능 화학섬유 제조를 위해 고분자를 방사할 때 정전기 방지 및 사절을 방지하는 기능성 방사유제 제조 기술
8		신한산업	사용 후 미생물에 의해 생분해되어 자연으로 되돌아가는 생분해성 섬유소재 및 응용제품 제조 기술
9	디스플레이	휴템	수 μm 크기의 고효율 마이크로 LED를 제조하거나 이를 이용하여 디스플레이 패널을 제조하기 위한 공정 장비 제조 기술
10		머티어리얼 사이언스	디스플레이 화소를 형성하기 위해 박막을 형성하여 전류를 흘렸을 때 빛을 내는 발광 소재 제조 기술
11	반도체	네오셈	반도체 기능 테스트, 반도체칩의 완성정도를 검사하는 장비 제조 기술
12		디아이	
13		엠케이피	반도체 소자를 구성하는 물질을 초박막 형태로 증착하는 부품·장비 제조 기술
14		레이크 머티리얼즈	
15		비아트론	반도체 웨이퍼 열처리 공정장비 제조 기술
16	수소	지티씨	수소 압축기용 다이어프램의 고내구성 소재, 씰링, 설계 및 가공 기술
17	우주 항공	송월테크놀로지	우주·항공용 품질 기준에 부합하는 고강도·고강성 탄소복합재 생산을 위한 탄소섬유 및 중간재 제조 기술, 수지 주입성형(RTM: Resin Transfer Molding) 공정 기술
18		스페이스프로	
19	자동차	태웅	회전속도를 변경해주는 동력전달시스템인 회전계용 내마모 특수강 제조 기술
20		삼환티에프	유기계 섬유 소재 제조 기술: 고강도, 고탄성률, 고내열성, 난연성, 내화학성을 가지는 극한성능 유기계 섬유 소재 제조 기술
21	전기전자	세미하우	전력제어 부품 제조 기술: 전력의 변환이나 제어를 하는 반도체 부품 제조 기술

참고5

2026년 뿌리산업 차세대 리더스 포럼 개요

□ 목 적

- 뿌리기업 차세대 리더*의 신시장 진출 및 AI·데이터를 활용한 공정 혁신의 경험 공유 및 업계 확산을 위한 현장 중심 정책 제언 도출

* 뿌리산업 현장에서 공정 고도화·지능화를 이끌며 성과를 내는 2세 경영인 등

□ 포럼 개요

- (일시) 2026. 10. 28.(수) 12:00 ~ 13:50
 - (장소) KINTEX 제1전시장 2층 세미나실
 - (참석자) 산업통상부, 생기원, 산기평, 뿌리기업 리더 등 15명 내외
- * 수도권(금형·소성·표면), 충청권(주조·용접), 경상권(열처리·표면·주조), 호남권(소성가공), SI 공급기업 대표 등

○ 주요 내용

- ① 뿌리 AX 지원을 위한 기술개발 및 혁신기반구축 현황 발표
- ② 현장 공정 지능화 구축 경험 공유
- ③ 뿌리 현장 애로 청취 및 실효적 정책 제언 도출

□ 행사 일정

※ 격려사까지 공개

일정		주요내용	비고
12:00~12:02	2'	• 개회	생기원
12:02~12:05	3'	• 격려사	산업부
12:05~12:30	25'	• 참석자소개 및 기업 동향 공유	오찬 병행
12:30~12:40	10'	• 휴식 및 네트워킹	
12:40~12:50	10'	• 뿌리산업 기술개발(R&D) 지원 방향	산기평
12:50~13:00	10'	• 뿌리 AX 추진 방향(금형·사출·가공 기반구축 사례 등)	금형센터
13:00~13:10	10'	• 뿌리 맞춤형 AX 솔루션 구축	SI 기업
13:10~13:40	30'	• 종합토론 - 현장공정 지원 방향, 포럼 정례화 등	
13:40~13:50	10'	• 종합 정리, 폐회	